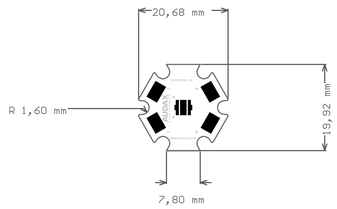
PCB			
Liberacao sim ○ nao ○	Tipo Type / Espessura da placa Board Thickness	Espessura do cobre Copper Plating / Tolerancia Espessura um Thickness um	
PF-CP02 (FR2)	0.8 ○	+/- 0.105	○
PF-CP02 (Chip)	○	+/- 0.155	⊗
PF-(CEM-1)	1.6 ○	+/- 0.100	○
PF-CP02 (FR4)	1.6 ○	+/- 0.1035	○
Al (MCPCB)	1.5 ⊗	+/- 0.10	○

1) Somente furacao 2) Incluindo espessura do cobre
1) Only drilling possible 2) Including copper plating

Creepage	Tipo de PCI PCB Type	
normal ⊗		
CTI ○	⊗ Simples face Single Sided	Dupla face Double Sided

Acabamento Metalizado Metal Plating		
Furos metalizados Holes through metal plated	sim ○	nao ⊗

Protecao superficial Surface Protection	Tipo de PCI PCB Type: Simples face Single Sided	Dupla face Double Sided
OSP	⊗	– – –
SnPb – electro plating remelting	○	
Rollertin plating	○	– – –
Hot tin plated LEAD FREE HAL (LF)		



Observacoes Remarks	Painel de Producao Production Panel
Por favor informar o Audax sobre alterações necessárias para fabricação. Please inform Audax of changes necessary for manufacturing	Alterações no Painel ? Panel changes ? nao ○
O PCB deve ser fornecido com a marca do fabricante (ver padrão). The PCB must be provided with manufacturer's mark (see standard).	Condições de Aceitação Acceptance Criteria
Todas dimensões em mm. Todas dimensões em mm. Tolerâncias gerais (não especificadas) conforme IPC-A-600 (classe 2). Tolerâncias gerais (não especificadas) conforme IPC-A-600 (classe 2).	Especificações de inspecção e critério de aceitação estão descritos no procedimento interno. Inspection specifications and acceptance criteria are described in IKB711 (technical terms of delivery).

Observacoes- SILKSCREEN COLOR BLACK / COR SILKSCREEN PRETO
– SOLDERMASK COLOR WHITE FOR LED/ COR DA MASCARA DE SOLDA BRANCO PARA LED (BRANCOLED)

Desenho de Producao Production Drawing / Desenhos documentos Drawings, documents		Requer Required	Desenho Drawing	Passo Step	Indicador de alteracao Change Index
Solder Paste Mask	Solder Side	○	○	○	
	Component Side	⊗	○	⊗	00
SMD Adhesive	Solder Side	○	○	○	
	Component Side	○	○	○	
Conductive Paste	Solder Side	○	○	○	
	Component Side	⊗	○	⊗	00
Solder Resist Mask	Solder Side	○	○	○	
	Component Side	⊗	○	⊗	00
Ident. Print Insulation	Component Side	⊗	○	⊗	00
Plan	Solder Side	○	○	○	
Esquematico Schematic		⊗	Indice de mudanca nao esta indicado aqui Change index not shown here		
Condicoes Tecnicas de Fornecimento Technical Terms of Delivery		○			
Removable Solder Resist Mask	Solder Side	○	○	○	
	Component Side	○	○	○	
Partial Coating	Solder Side	○	○	○	
	Component Side	○	○	○	
Lista de coordenadas Pick and Placement		⊗	○	⊗	00
Desenho policiso Artwork drawing		○			

Rev Iss	Nr. Modif Chg. Mod	Modificacao Modific / chg–Note	Data Date	Nome Name	Rev Iss	Nr. Modif Chg. Mod	Modificacao Modific / chg–Note	Data Date	Nome Name
00	–––––	LIBERACAO	08.11.2017	PJR					

Nao podem ser alterados manualmente
May not be changed manually

Angulo de projecao
First Angle Projection

	Data Date	Nome Name
Desenho Drawn	08.11.2017	PJR
Revisado Checked	08.11.2017	THIAGO
Aprovado Apr.	08.11.2017	VICTOR

AUDAX ELECTRONICS

Escala / Scale

Tratamento Superficial / Surface Coating

Tolerancias gerais / General tolerances

Projeto No. / Project No.

Tipo de Material / Material Form

Documentacao / Documentation

Materail / Material

Todo direitos reservados
All rights reserved

No. Artigo / Article No.

No. Documento / Document No.

Arq. Rev. / Arq. Iss.

Classificacao / Classification

Tipo Doc. / Doc. Type

Titulo / Title –––––

Part No. 216102187001

Arq. Rev. / Arq. Iss. 00